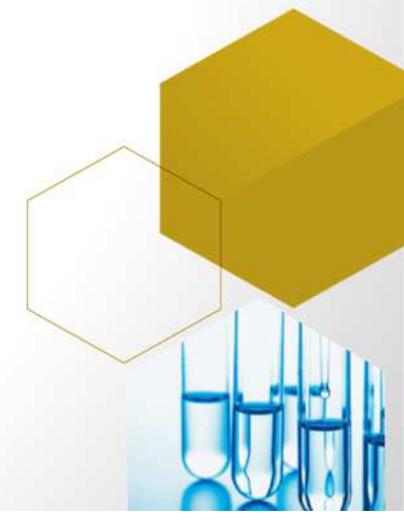
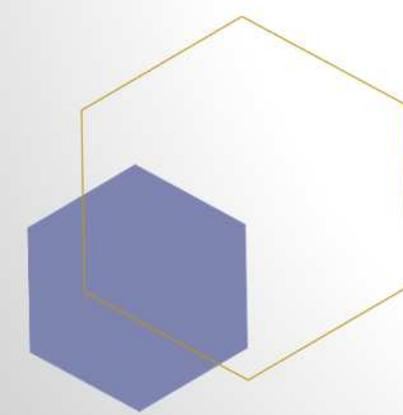


2022年3月期 第2四半期決算説明資料



 日本高純度化学株式会社

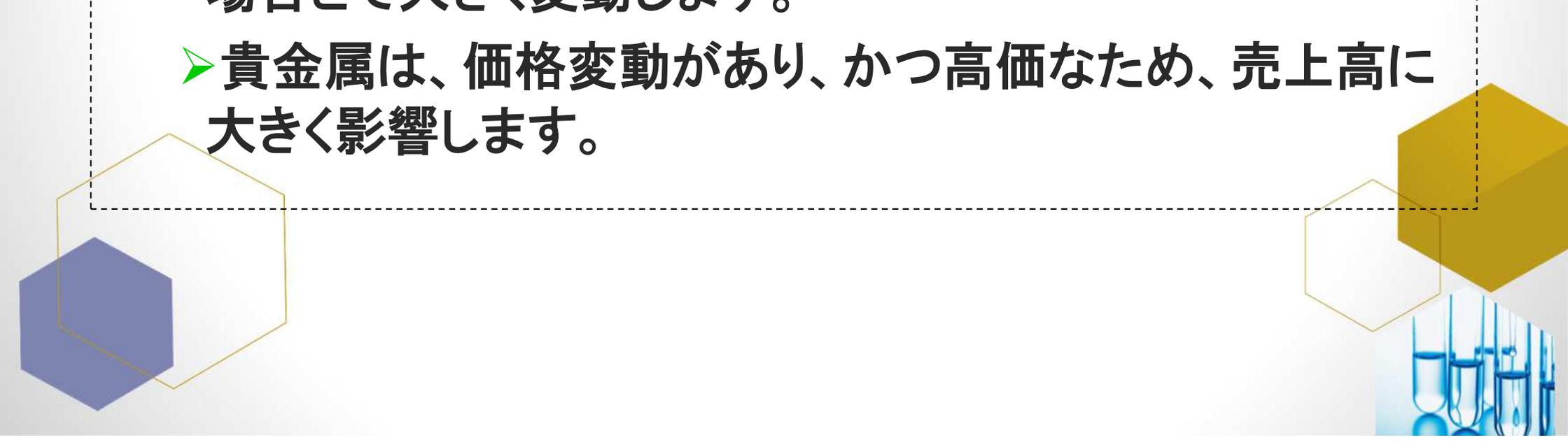
証券コード:4973

2021年10月25日



決算の概況

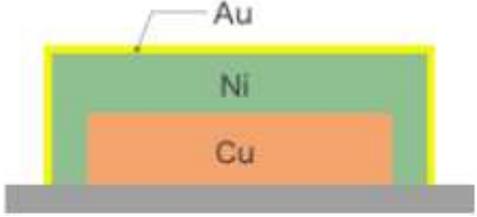
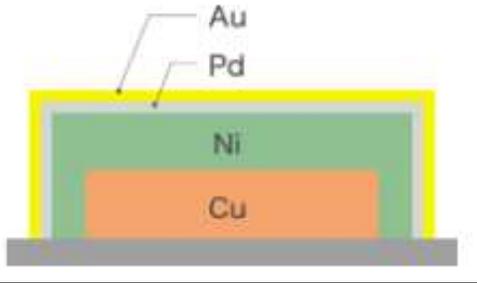
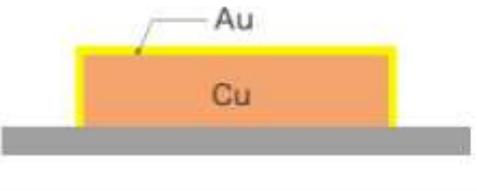
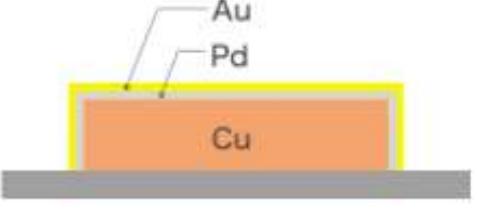
(注)当社業績の見方のポイント

- ▶ 売上高は、薬品と一緒に貴金属を売る場合と、売らない場合とで大きく変動します。
 - ▶ 貴金属は、価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 

用語説明①(めっき方式)

| 用語 | 用途 | 説明 |
|--------------------------|-------------------|--|
| 電解めっき (電気めっき) | — | 金属などの表面に電気を流してめっきする方法 |
| 純金めっき | プリント基板 半導体搭載基板 | 純度が高い金めっき |
| 硬質金めっき | コネクタ プリント基板 | 合金成分を入れて硬くした金めっき |
| パラジウム (Pd)めっき | リードフレーム コネクタ | 金めっきの下地めっきとして使用される。 PPFはPre Plated Lead frameの略 |
| 無電解めっき | — | 電気を流さず化学反応によりめっきする方法 |
| 置換めっき | プリント基板 | 金属ごとの溶けやすさ(イオン化傾向)を利用し、表面の金属を置き換えて形成するめっき方法 |
| 還元めっき | プリント基板 | 還元剤による化学反応を利用して厚く形成できるめっき方法 |

用語説明②(めっきプロセス)

| 用語 | 説明 | めっき層構成 |
|--------|--|---|
| ENIG | 銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Immersion Goldの略。層構成はCu-Ni-Au |  |
| ENEPIG | 銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略。層構成はCu-Ni-Pd-Au |  |
| DIG | 銅上に置換金めっきを直接する方法。Direct Immersion Goldの略。Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。層構成はCu-Au |  |
| EPIG | 銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Palladium Immersion Goldの略。層構成はCu-Pd-Au |  |

製品ラインアップ ~ラインアップ拡充と新分野開拓~

| めっき方式 | 用途 | 製品ラインアップ |
|-------|--|--|
| 電解 | 純金  | ① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき |
| | 硬質金 (合金)  | マイクロコネクタ用省金硬質金めっき オーロブライト BAR7 |
| | パラジウム(Pd)  | PPF用薄膜パラジウムめっき パラブライト NANO2 |
| 無電解 | 置換金  | 中～高リンニッケルで使える置換金めっき IM-GOLD IB2X 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき IM-GOLD CN ニッケルめっきが不要な置換金めっき IM-GOLD PC |
| | 還元金  | 亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD シアン化金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD CN |
| | 還元Pd  | ENEPIG用還元パラジウムめっき ネオパラブライト 2 ダイレクト還元パラジウムめっき ネオパラブライト DP |

新分野

卑金属(銅、スズ、ニッケル)
合金めっき 後処理剤など

2022年3月期 第2四半期の概況

電子部品業界の状況

- 5G(第5世代移動通信システム)対応スマートフォンの拡大や、リモートワーク、オンライン学習の浸透に伴うパソコン関連の需要により堅調に推移した。
- 車載用電子部品については、自動車の需要に回復が見られたものの、コロナウイルス感染拡大による東南アジアからの部品供給の滞りや、半導体供給不足が自動車生産に影響を及ぼした。

当社決算の概況

- プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品の販売が、5G対応スマートフォン向けやリモートワーク、オンライン学習の浸透に伴うパソコン関連向けの需要により堅調に推移した。
- コネクタ用めっき薬品の販売では、5G対応スマートフォン向けの需要に支えられ堅調に推移した。
- リードフレーム用めっき薬品の販売は、通信機器向けの需要増加と共に、貴金属パラジウム価格の高騰に伴い好調に推移した。

2022年3月期 第2四半期決算概況

(単位:百万円、%)

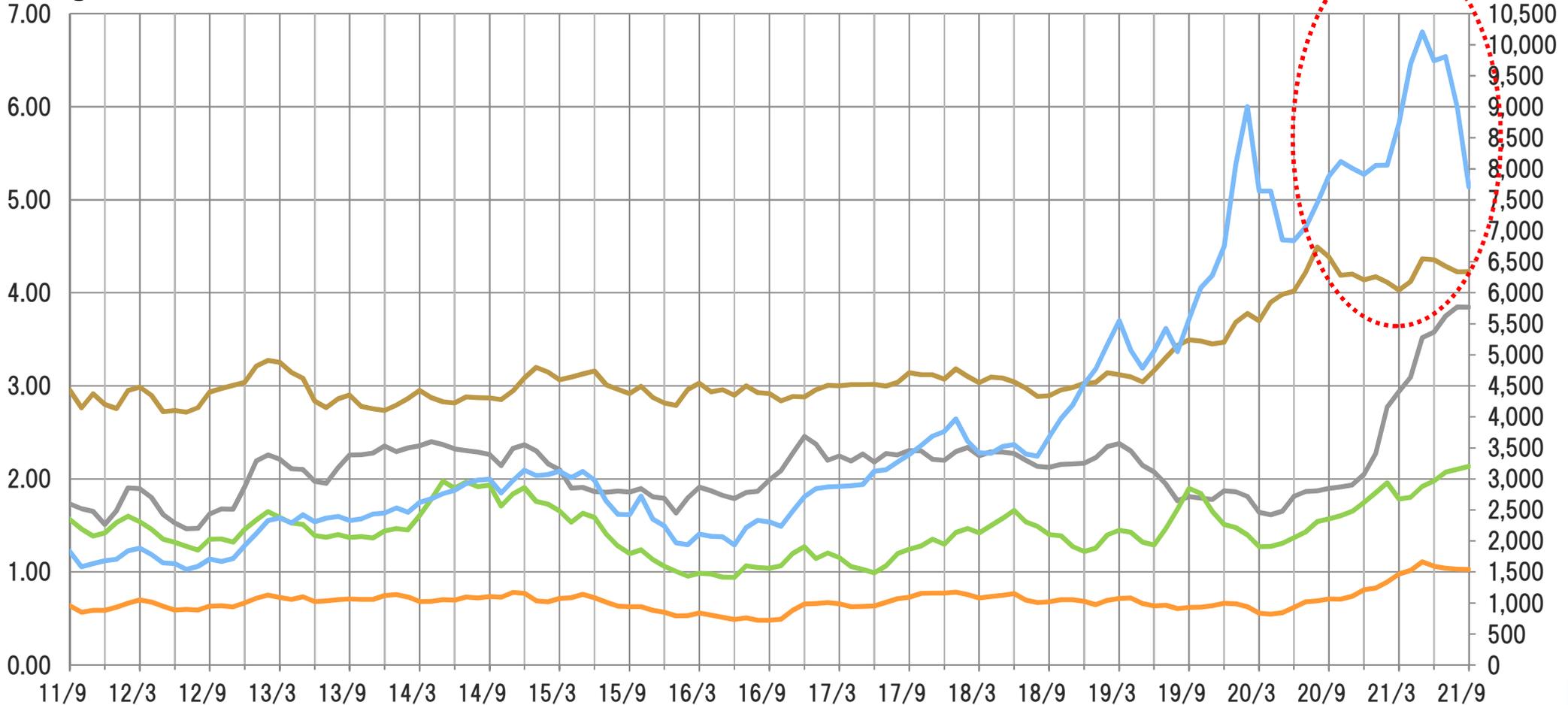
| | 2021/3期 1Q~2Q | 2022/3期 | | | | 2022/3期予想 | |
|----------------|------------------|---------|--------|--------|------|-----------|------|
| | | 1Q | 2Q | 1Q~2Q | 増減率 | | 達成率 |
| 売上高 | 7,720 | 5,108 | 4,603 | 9,711 | 25.8 | 17,000 | 57.1 |
| 営業利益 | 405 | 266 | 252 | 518 | 27.8 | 1,090 | 47.5 |
| 経常利益 | 464 | 326 | 256 | 582 | 25.4 | 1,200 | 48.6 |
| 純利益 | 346 | 237 | 189 | 426 | 23.0 | 870 | 49.0 |
| 1株当たり 当期純利益 | 59.91円 | 40.88円 | 32.32円 | 73.17円 | — | 150.08円 | — |

メタル相場推移

Prices of copper, tin and nickel
銅、スズ、ニッケル価格

Copper 銅 Tin スズ Nickel ニッケル

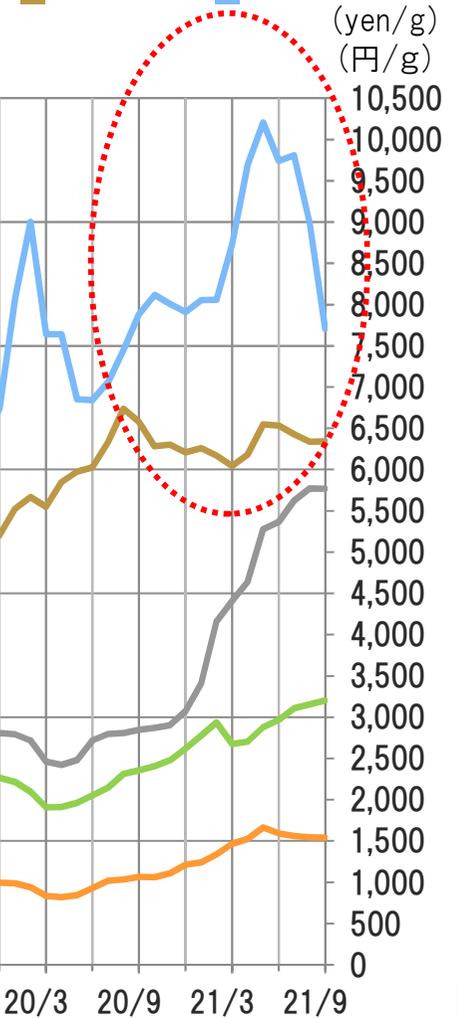
(yen/g)
(円/g)



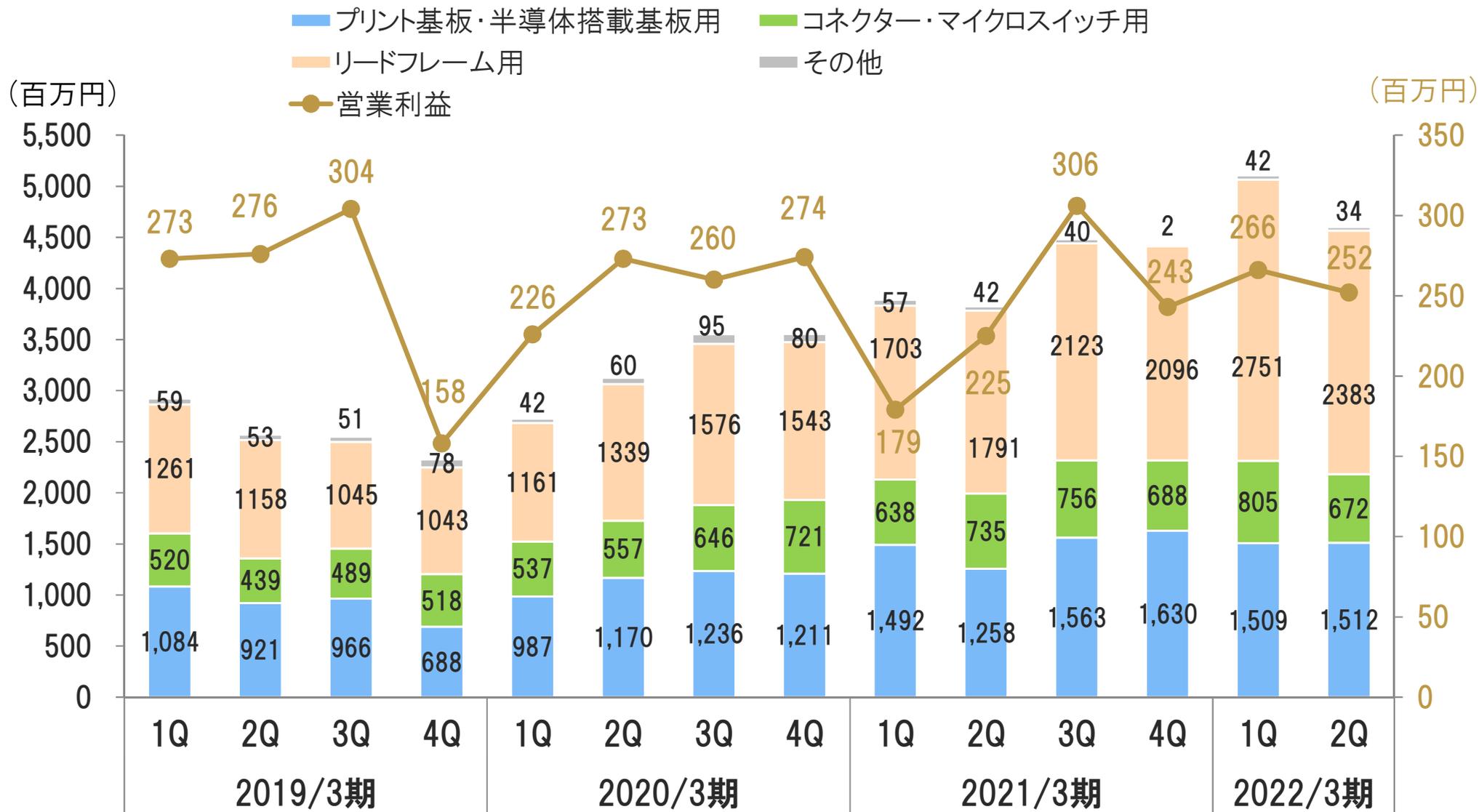
Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格

Gold 金 Palladium パラジウム

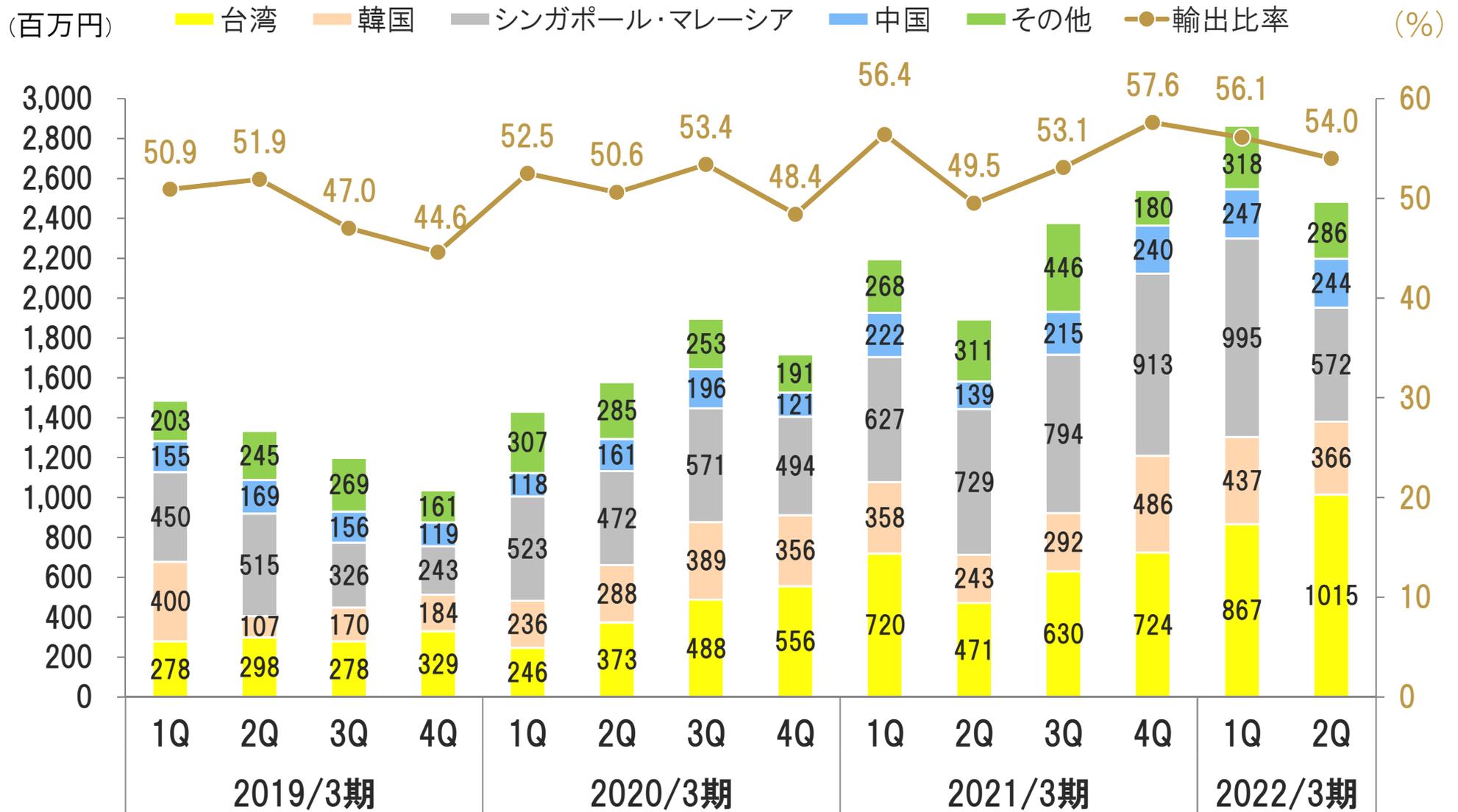
(yen/g)
(円/g)



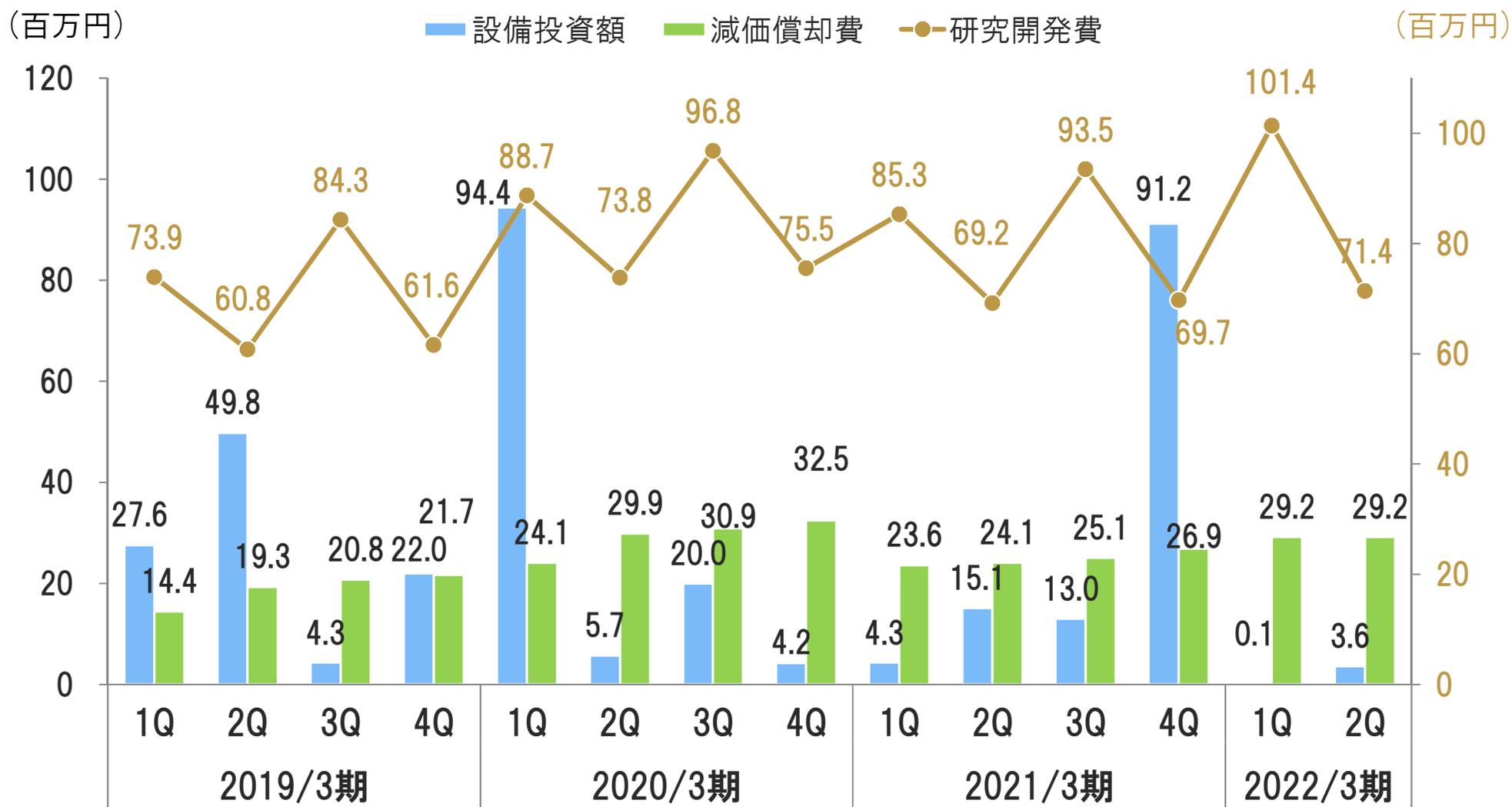
売上高・営業利益の推移(四半期ベース)



輸出地域別売上高の推移(四半期ベース)



設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移



通期の見通し

(単位:百万円、%)

| | 2021/3期 | | | 2022/3期 | | |
|-------|---------|-------|------|---------|-------|------|
| | | 構成比 | 前期比 | | 構成比 | 前期比 |
| 売上高 | 16,622 | 100.0 | 28.2 | 17,000 | 100.0 | 2.3 |
| 営業利益 | 955 | 5.7 | ▲7.7 | 1,090 | 6.4 | 14.1 |
| 経常利益 | 1,069 | 6.4 | ▲8.2 | 1,200 | 7.1 | 12.2 |
| 当期純利益 | 790 | 4.8 | ▲7.9 | 870 | 5.1 | 10.1 |

トピックス

- **硬質金(金合金)**・・・マイクロコネクタ用硬質金めっき薬品を拡販中
- **DIG(銅上ダイレクト金)**・・・ENIGに代わる高周波特性・高解像度対応プロセスとして拡販中
- **EPIG(銅上ダイレクトパラジウム/金)**・・・巨大なIoT市場に展開できるよう、技術・営業両面でフォロー中

いずれも業界動向や顧客ニーズに迅速に対応できるよう積極的に拡販活動をおこなっております。

配当について

(単位:円、%)

| | 通期 | 1株当たり 当期純利益 | 配当性向 |
|-------------|----|----------------|------|
| 2017/3期 | 80 | 124.44 | 64.3 |
| 2018/3期 | 80 | 144.13 | 55.5 |
| 2019/3期 | 80 | 146.36 | 54.7 |
| 2020/3期 | 80 | 148.58 | 53.8 |
| 2021/3期 | 80 | 136.53 | 58.6 |
| 2022/3期(予想) | 80 | 150.08 | 53.3 |

ESG/SDGsへの取り組み

当社のめっき薬品は、電子部品業界で広く使われ、近年ではスマートフォン市場に留まらず、電動化・電装化が進む自動車市場、IoT化が進む産業機械市場など、幅広い分野へ進出しております。

今後も事業を通じてESG/SDGsに関する取り組みを進めてまいります。

●環境に配慮し、貴金属資源の有効活用につながる製品を顧客に訴求

- ・貴金属使用量を減らすことのできる省金めっき薬品を顧客に提供

●社会貢献活動の促進

- ・JPC奨学財団の設立及び運営

大学・大学院の学生に給付型奨学金を支給し、教育を支援

コロナ禍を機に支給額を増額

(2021年4月)



●コーポレートガバナンスの強化

- ・取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置 (2019年6月)

- ・英文招集通知及び議決権電子行使を導入 (2020年6月)

今後の展開

① 当社貴金属めっきシェアを拡大



新用途のキャッチアップ

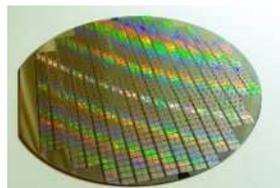
② 当社があまり手を付けてこなかった 貴金属めっき市場を開拓



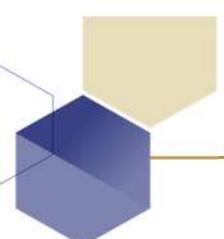
海外車載コネクタ需要のキャッチアップ

③ 半導体・先端パッケージ開発に対応する めっき技術への挑戦

★ 貴金属めっきで培ったユニークな技術を他のめっき技術に展開



有機基板から
ウェハー、先端パッケージへ



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2021年9月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>

補足資料： 会社紹介

沿革

- 1971年7月 会社設立
- 1999年11月 MBOを実施
- 2002年12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年3月 東京証券取引所市場第一部に指定
- 2019年2月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき工程に絞り世界シェアトップ
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献